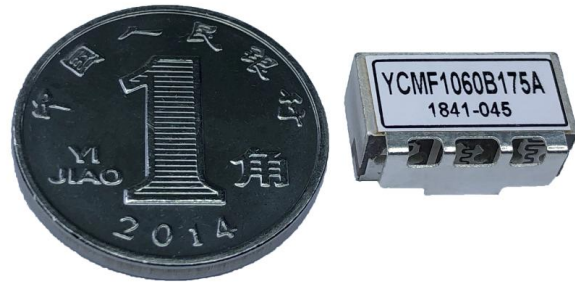


特点:

- 高带外抑制:
 $f_0 \pm 155\text{MHz} \geq 30\text{dB}$
- 良好的带内驻波比: 典型值 1.5:1
- SMT 封装
- 封装尺寸: 13.0×7.8×5mm
- 工作温度: -55~+85℃
- 产品执行标准为 SJ20764-1999

图片:

性能参数: (T_A=25℃, 50Ω系统)

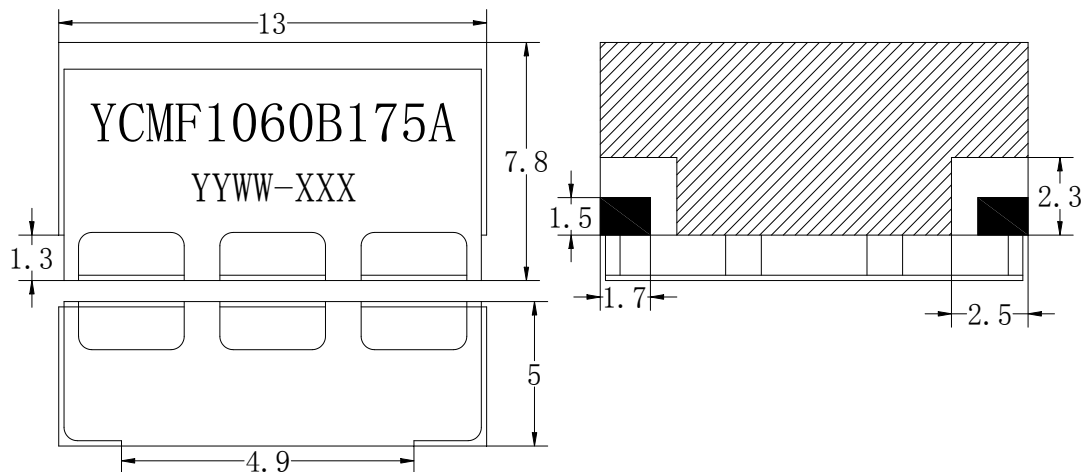
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
中心频率	f_0		1060±3			MHz	
-3dB 带宽	BW _{-3dB}		175		190	MHz	全温
插入损耗	IL	P _{IN} =0dBm f _{TEST} =1060MHz		2.0	2.5	dB	全温
输入带内驻波比	VSWR _i	P _{IN} =0dBm f _{TEST} =1025~1095MHz		1.5:1	2.0:1		全温
输出带内驻波比	VSWR _o			1.5:1	2.0:1		全温
阻带抑制	SR ₁	P _{IN} =0dBm f _{TEST} =1~830MHz	50			dB	全温
	SR ₂	P _{IN} =0dBm f _{TEST} =830~905MHz	30			dB	全温
	SR ₃	P _{IN} =0dBm f _{TEST} =1215~1290MHz	30			dB	全温
	SR ₄	P _{IN} =0dBm f _{TEST} =1290~1700MHz	50			dB	全温
质量	m				10.0	g	

极限参数表:

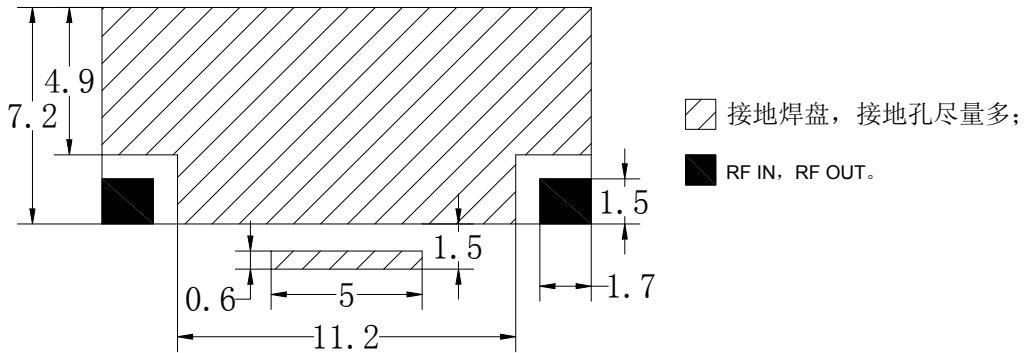
参数名称	极限值	单位
贮存温度	-55~+100	℃
输入射频功率	30.0	dBm

封装外形及引脚标识图:

单位: mm 公差: ±0.3mm





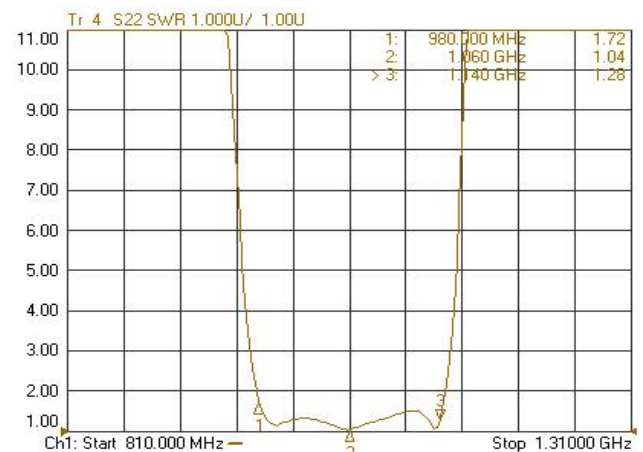
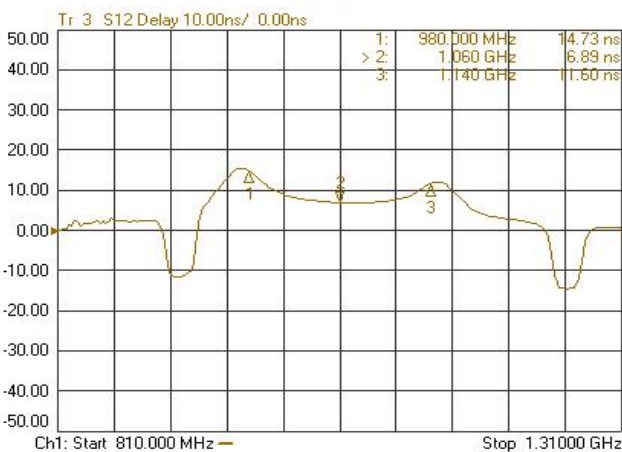
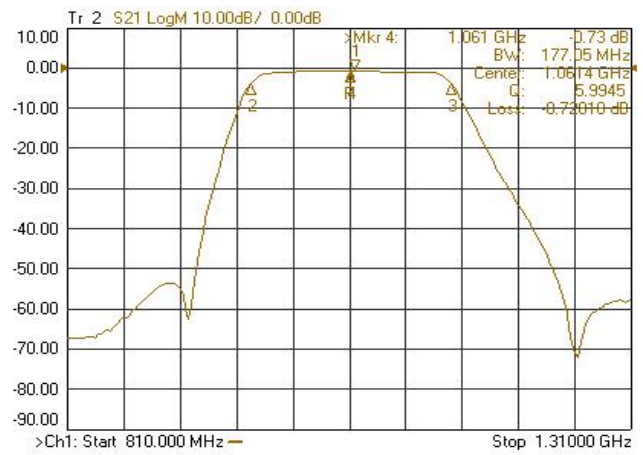
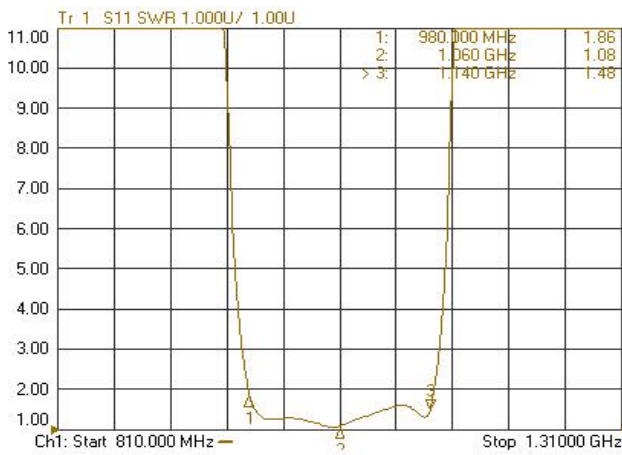
表面处理: 陶瓷介质镀银, 屏蔽罩镀镍。

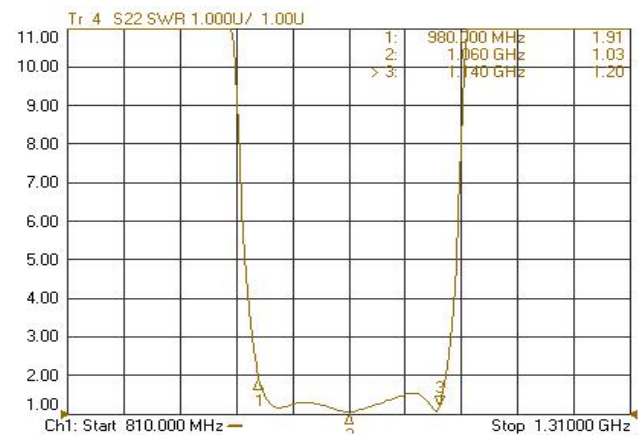
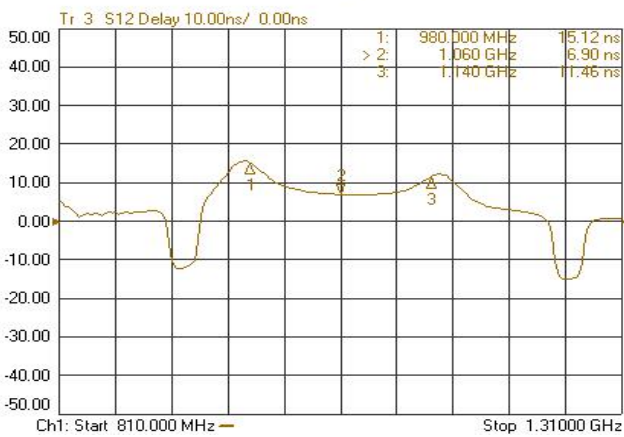
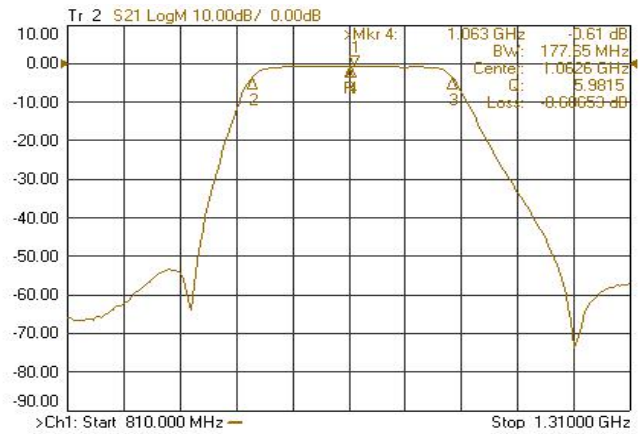
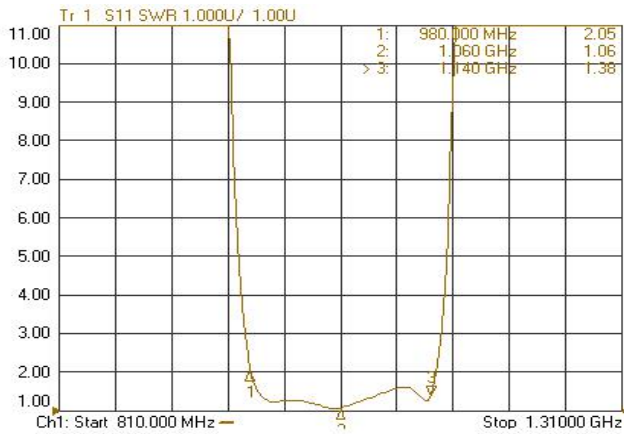
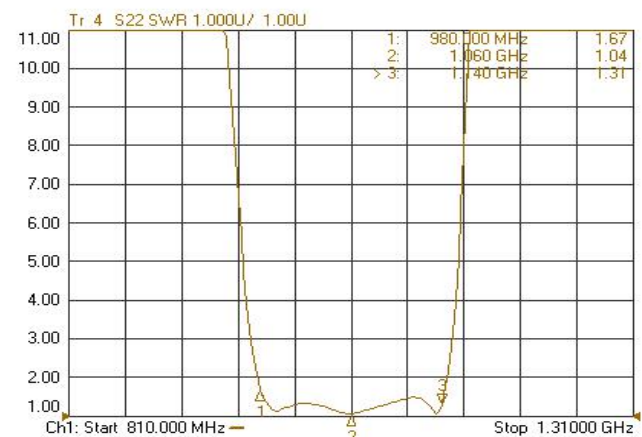
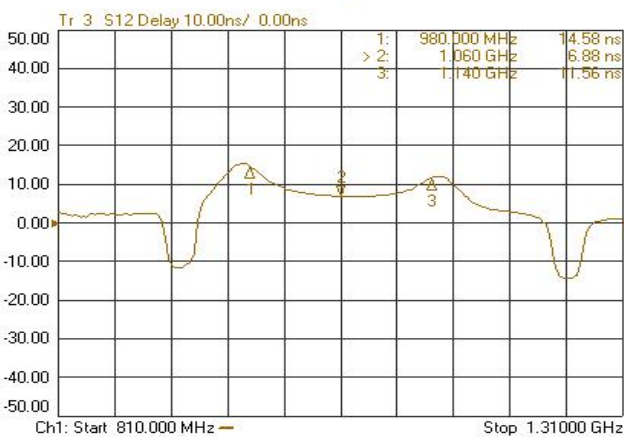
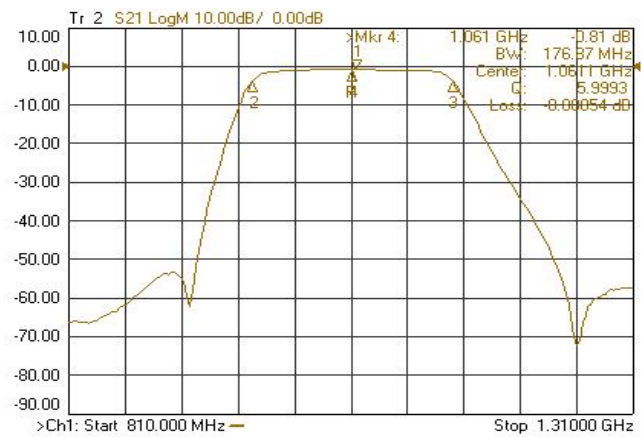
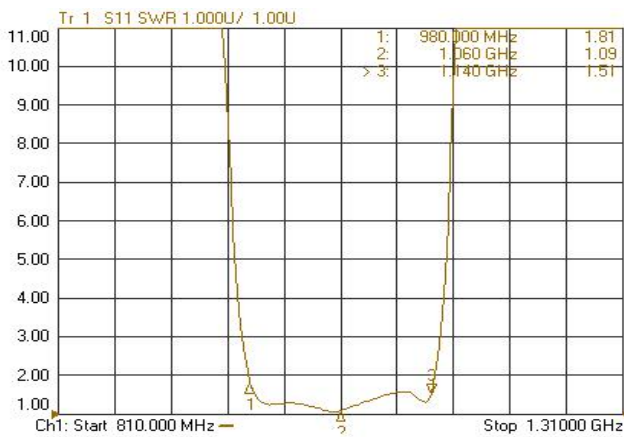
推荐焊盘图:

字符标志:

YCMF1060B175A	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义:

接口标识	接口说明
	RF IN, RF OUT (可互换)
	GND

典型测试曲线:
+25°C 带内指标典型曲线


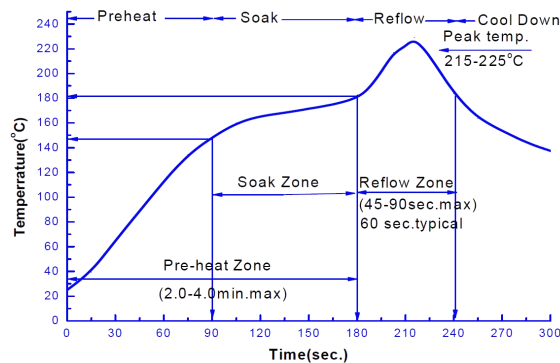
-55°C带内指标典型曲线

+85°C带内指标典型曲线


带外抑制典型曲线



产品使用注意事项:

- 1.产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，推荐采用采用组份≥2%的含银焊膏回流焊接，回流温度推荐曲线：



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

- 4.如特殊情况需采用手工补焊，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。
7. 其他使用注意事项参考成都宇熙《微波介质陶瓷滤波器产品使用说明》。